

# 2024-2030年中国芯片设计 市场深度评估与投资方向研究报告

## 报告目录及图表目录

北京迪索共研咨询有限公司

[www.cction.com](http://www.cction.com)

## 一、报告报价

《2024-2030年中国芯片设计市场深度评估与投资方向研究报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.cction.com/report/202406/462334.html>

报告价格：纸介版8000元 电子版8000元 纸介+电子8500元

北京迪索共研咨询有限公司

订购电话: 400-700-9228(免长话费) 010-69365838

海外报告销售: 010-69365838

Email: kefu@gonyn.com

联系人：李经理

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

## 二、说明、目录、图表目录

中企顾问网发布的《2024-2030年中国芯片设计市场深度评估与投资方向研究报告》报告中的资料和数据来源于对行业公开信息的分析、对业内资深人士和相关企业高管的深度访谈，以及共研分析师综合以上内容作出的专业性判断和评价。分析内容中运用共研自主建立的产业分析模型，并结合市场分析、行业分析和厂商分析，能够反映当前市场现状，趋势和规律，是企业布局市场服务行业的重要决策参考依据。

报告目录：

### 第1章：芯片设计行业界定及数据统计标准说明

#### 1.1 芯片设计的界定与战略地位分析

##### 1.1.1 芯片设计的定义

##### 1.1.2 芯片设计的战略地位分析

#### 1.2 芯片设计行业专业术语介绍

#### 1.3 芯片设计相关概念的界定与区分

#### 1.4 芯片设计行业归属国民经济行业分类

#### 1.5 本报告芯片设计行业的研究范围界定说明

#### 1.6 本报告数据来源及统计标准说明

### 第2章：中国芯片设计行业PEST（宏观环境）分析

#### 2.1 中国芯片设计行业政治（Politics）环境

##### 2.1.1 芯片设计行业监管体系及机构介绍

###### （1）行业主管部门

###### （2）行业自律组织

##### 2.1.2 芯片设计行业标准体系建设现状

###### （1）标准体系建设

###### （2）现行标准汇总

###### （3）即将实施标准

###### （4）重点标准解读

##### 2.1.3 芯片设计行业发展相关政策规划汇总及解读

###### （1）芯片设计行业发展相关政策汇总

###### （2）芯片设计行业发展相关规划汇总

- 2.1.4 “十四五”规划对行业发展的影响分析
- 2.1.5 “碳中和、碳达峰”战略的提出对行业的影响分析
- 2.1.6 政策环境对行业发展的影响分析
- 2.2 中国芯片设计行业经济（Economy）环境
  - 2.2.1 宏观经济发展现状
  - 2.2.2 宏观经济发展展望
  - 2.2.3 芯片设计行业发展与宏观经济相关性分析
- 2.3 中国芯片设计行业社会（Society）环境
- 2.4 中国芯片设计行业技术（Technology）环境
  - 2.4.1 芯片设计流程
  - 2.4.2 芯片设计研发创新性现状
  - 2.4.3 芯片设计行业相关专利的申请及公开情况
    - （1）专利申请
    - （2）专利公开
    - （3）热门申请人
    - （4）热门技术
  - 2.4.4 技术环境对行业发展的影响分析

### 第3章：全球芯片设计行业发展现状及趋势前景预判

- 3.1 全球芯片设计行业发展历程
- 3.2 全球芯片设计行业发展环境
- 3.3 全球芯片设计行业发展现状
- 3.4 全球芯片设计行业市场规模测算
- 3.5 全球主要经济体芯片设计行业发展状况
  - 3.5.1 美国芯片设计行业发展状况
  - 3.5.2 德国芯片设计行业发展状况
  - 3.5.3 日本芯片设计行业发展状况
  - 3.5.4 其他国家/地区芯片设计行业发展状况
- 3.6 全球芯片设计行业市场竞争格局及兼并重组状况
  - 3.6.1 全球芯片设计行业市场竞争状况
  - 3.6.2 全球芯片设计企业兼并重组状况
- 3.7 全球芯片设计行业代表性企业发展布局案例

- 3.7.1 全球芯片设计行业代表性企业布局对比
- 3.7.2 全球芯片设计行业代表性企业布局案例
  - (1) 博通(AVGO.US)
  - (2) 高通(QCOM.US)
  - (3) 英伟达(NVDA.US)
  - (4) 联发科
  - (5) 美国超微公司(AMD.US)
- 3.8 全球芯片设计行业发展趋势及市场前景预测
  - 3.8.1 全球芯片设计行业发展趋势预判
  - 3.8.2 全球芯片设计行业市场前景预测

#### 第4章：中国芯片设计产业链梳理及上游行业布局状况

- 4.1 中国芯片设计产业结构属性（产业链）
  - 4.1.1 芯片设计产业链结构梳理
  - 4.1.2 芯片设计产业链生态图谱
- 4.2 中国芯片设计产业价值属性（价值链）
  - 4.2.1 芯片设计行业成本结构分析
  - 4.2.2 芯片设计行业价值链分析
- 4.3 中国芯片设计上游制造材料和封装材料供应市场分析
  - 4.3.1 芯片设计上游制造材料和封装材料概述
  - 4.3.2 芯片设计上游制造材料和封装材料供应状况
  - 4.3.3 芯片设计上游制造材料和封装材料供应商格局
  - 4.3.4 芯片设计上游制造材料和封装材料价格水平
  - 4.3.5 芯片设计上游制造材料和封装材料对行业发展的影响分析
- 4.4 中国芯片设计上游EDA软件供应市场分析
  - 4.4.1 芯片设计上游EDA软件概述
  - 4.4.2 芯片设计上游EDA软件供应状况
  - 4.4.3 芯片设计上游EDA软件供应商格局
  - 4.4.4 芯片设计上游EDA软件价格水平
  - 4.4.5 芯片设计上游EDA软件对行业发展的影响分析
- 4.5 中国芯片设计产业链上游IP指令集市场分析
  - 4.5.1 IP指令集概述

- 4.5.2 IP指令集供应状况
- 4.5.3 IP指令集供应商格局
- 4.5.4 IP指令集发展趋势
- 4.5.5 IP指令集对芯片设计的影响分析

## 第5章：中国芯片设计产业市场供需状况分析

- 5.1 中国芯片设计行业发展历程介绍
- 5.2 中国芯片设计加工制造市场特性分析
- 5.3 中国芯片设计产业参与者类型及规模
- 5.4 中国芯片设计行业参与者入场方式
- 5.5 中国芯片设计服务供给水平
- 5.6 中国芯片设计服务价格行情及走势
- 5.7 中国芯片设计行业市场需求分析
- 5.8 中国芯片设计行业市场规模测算

## 第6章：中国芯片设计行业竞争状况及国际竞争力分析

- 6.1 中国芯片设计行业波特五力模型分析
  - 6.1.1 芯片设计行业现有竞争者之间的竞争
  - 6.1.2 芯片设计行业关键要素的供应商议价能力分析
  - 6.1.3 芯片设计行业消费者议价能力分析
  - 6.1.4 芯片设计行业潜在进入者分析
  - 6.1.5 芯片设计行业替代品风险分析
  - 6.1.6 芯片设计行业竞争情况总结
- 6.2 中国芯片设计行业投融资、兼并与重组状况
  - 6.2.1 中国芯片设计行业投融资发展状况
  - 6.2.2 中国芯片设计行业兼并与重组状况
- 6.3 中国芯片设计行业市场竞争格局分析
- 6.4 中国芯片设计行业市场集中度分析
- 6.5 中国芯片设计行业海外布局状况
- 6.6 中国芯片设计行业国际竞争力分析

## 第7章：中国芯片制造行业发展状况及对芯片设计的需求分析

- 7.1 中国芯片制造行业发展历程
- 7.2 中国芯片制造行业供需状况
- 7.3 中国芯片制造行业市场规模
- 7.4 中国芯片制造行业竞争格局
- 7.5 中国芯片制造行业区域发展格局
- 7.6 中国芯片制造国产化布局现状
- 7.7 中国芯片设计行业国产化布局现状

## 第8章：中国芯片设计智能终端应用场景需求潜力分析

- 8.1 中国芯片设计下游应用场景结构
- 8.2 工业控制领域的芯片设计需求分析
  - 8.2.1 工业控制领域智能化发展现状
  - 8.2.2 工业控制领域芯片及芯片设计需求分析
- 8.3 汽车电子领域的芯片设计需求分析
  - 8.3.1 汽车行业智能化发展现状
  - 8.3.2 汽车领域芯片及芯片设计需求分析
- 8.4 电力电子领域的芯片设计需求分析
  - 8.4.1 电力行业智能化发展现状
  - 8.4.2 电力电子领域的芯片及芯片设计需求分析
- 8.5 医疗电子领域的芯片设计需求分析
  - 8.5.1 医疗智能化发展现状
  - 8.5.2 医疗电子领域芯片及芯片设计需求分析
- 8.6 通讯设备领域的芯片设计需求分析
  - 8.6.1 通讯领域智能化发展现状
  - 8.6.2 通讯设备领域芯片及芯片设计需求分析
- 8.7 其他智能终端的芯片设计需求分析

## 第9章：中国芯片设计行业市场痛点及竞争力提升路径

- 9.1 中国芯片设计行业经营效益分析
- 9.2 中国芯片设计行业市场痛点分析
- 9.3 中国芯片设计竞争力提升路径
- 9.4 中国芯片设计竞争力提升布局现状

## 第10章：中国芯片设计产业链代表性企业案例研究

### 10.1 中国芯片设计产业链代表性企业发展布局对比

### 10.2 中国芯片设计产业链代表性企业发展布局案例（排名不分先后）

#### 10.2.1 深圳市海思半导体有限公司

- （1）企业发展历程及基本信息
- （2）企业发展状况
- （3）企业芯片设计业务类型及产品介绍
- （4）企业芯片设计产业链布局状况
- （5）企业转型升级发展布局状况
- （6）企业芯片设计业务布局优劣势分析

#### 10.2.2 紫光集团有限公司

- （1）企业发展历程及基本信息
- （2）企业发展状况
- （3）企业芯片设计业务类型及产品介绍
- （4）企业芯片设计产业链布局状况
- （5）企业转型升级发展布局状况
- （6）企业芯片设计业务布局优劣势分析

#### 10.2.3 北京豪威科技有限公司

- （1）企业发展历程及基本信息
- （2）企业发展状况
- （3）企业芯片设计业务类型及产品介绍
- （4）企业芯片设计产业链布局状况
- （5）企业转型升级发展布局状况
- （6）企业芯片设计业务布局优劣势分析

#### 10.2.4 深圳市中兴微电子技术有限公司

- （1）企业发展历程及基本信息
- （2）企业发展状况
- （3）企业芯片设计业务类型及产品介绍
- （4）企业芯片设计产业链布局状况
- （5）企业转型升级发展布局状况
- （6）企业芯片设计业务布局优劣势分析

#### 10.2.5 华大半导体有限公司

- (1) 企业发展历程及基本信息
- (2) 企业发展状况
- (3) 企业芯片设计业务类型及产品介绍
- (4) 企业芯片设计产业链布局状况
- (5) 企业转型升级发展布局状况
- (6) 企业芯片设计业务布局优劣势分析

#### 10.2.6 深圳市汇顶科技股份有限公司

- (1) 企业发展历程及基本信息
- (2) 企业发展状况
- (3) 企业芯片设计业务类型及产品介绍
- (4) 企业芯片设计产业链布局状况
- (5) 企业转型升级发展布局状况
- (6) 企业芯片设计业务布局优劣势分析

#### 10.2.7 杭州士兰微电子股份有限公司

- (1) 企业发展历程及基本信息
- (2) 企业发展状况
- (3) 企业芯片设计业务类型及产品介绍
- (4) 企业芯片设计产业链布局状况
- (5) 企业转型升级发展布局状况
- (6) 企业芯片设计业务布局优劣势分析

#### 10.2.8 北京兆易创新科技股份有限公司

- (1) 企业发展历程及基本信息
- (2) 企业发展状况
- (3) 企业芯片设计业务类型及产品介绍
- (4) 企业芯片设计产业链布局状况
- (5) 企业转型升级发展布局状况
- (6) 企业芯片设计业务布局优劣势分析

#### 10.2.9 北京智芯微电子科技有限公司

- (1) 企业发展历程及基本信息
- (2) 企业发展状况
- (3) 企业芯片设计业务类型及产品介绍

- (4) 企业芯片设计产业链布局状况
- (5) 企业转型升级发展布局状况
- (6) 企业芯片设计业务布局优劣势分析

#### 10.2.10 大唐恩智浦半导体有限公司

- (1) 企业发展历程及基本信息
- (2) 企业发展状况
- (3) 企业芯片设计业务类型及产品介绍
- (4) 企业芯片设计产业链布局状况
- (5) 企业转型升级发展布局状况
- (6) 企业芯片设计业务布局优劣势分析

### 第11章：中国芯片设计行业发展潜力评估及市场前景预判

- 11.1 中国芯片设计产业链布局诊断
- 11.2 中国芯片设计行业发展机遇与挑战分析
- 11.3 中国芯片设计行业发展潜力评估
- 11.4 中国芯片设计行业发展前景预测
- 11.5 中国芯片设计行业发展趋势预判

### 第12章：中国芯片设计行业投资特性及投资机会分析

- 12.1 中国芯片设计行业投资风险预警及防范
  - 12.1.1 芯片设计行业政策风险及防范
  - 12.1.2 芯片设计行业技术风险及防范
  - 12.1.3 芯片设计行业宏观经济波动风险及防范
  - 12.1.4 芯片设计行业关联产业风险及防范
  - 12.1.5 芯片设计行业其他风险及防范
- 12.2 中国芯片设计行业市场进入壁垒分析
  - 12.2.1 芯片设计行业人才壁垒
  - 12.2.2 芯片设计行业技术壁垒
  - 12.2.3 芯片设计行业资金壁垒
  - 12.2.4 芯片设计行业其他壁垒
- 12.3 中国芯片设计行业投资价值评估
- 12.4 中国芯片设计行业投资机会分析

- 12.4.1 芯片设计行业产业链薄弱环节投资机会
- 12.4.2 芯片设计行业细分领域投资机会
- 12.4.3 芯片设计行业区域市场投资机会
- 12.4.4 芯片设计产业空白点投资机会

## 第13章：中国芯片设计行业投资策略与可持续发展建议

- 13.1 中国芯片设计行业投资策略与建议
- 13.2 中国芯片设计行业可持续发展建议

## 图表目录

- 图表1：本报告芯片设计齿轮箱行业研究范围界定
- 图表2：本报告的主要数据来源及统计标准说明
- 图表3：芯片设计行业主管部门
- 图表4：芯片设计行业自律组织
- 图表5：截至2021年芯片设计行业标准汇总
- 图表6：截至2021年芯片设计行业发展政策汇总
- 图表7：截至2021年芯片设计行业发展规划汇总
- 图表8：全球芯片设计行业发展趋势预判
- 图表9：2022-2027年芯片设计行业市场前景预测
- 图表10：芯片设计产业链结构
- 图表11：芯片设计产业链生态图谱
- 图表12：芯片设计上游制造材料和封装材料对行业发展的影响分析
- 图表13：芯片设计上游EDA软件对行业发展的影响分析
- 图表14：芯片设计行业生产企业
- 图表15：芯片设计行业现有企业的竞争分析表
- 图表16：芯片设计行业对上游议价能力分析表
- 图表17：芯片设计行业对下游议价能力分析表
- 图表18：芯片设计行业潜在进入者威胁分析表
- 图表19：中国芯片设计行业五力竞争综合分析
- 图表20：中国芯片设计行业市场发展痛点分析
- 图表21：中国芯片设计产业链代表性企业发展布局对比
- 图表22：深圳市海思半导体有限公司发展历程

- 图表23：深圳市海思半导体有限公司基本信息表
- 图表24：深圳市海思半导体有限公司股权穿透图
- 图表25：深圳市海思半导体有限公司经营状况
- 图表26：深圳市海思半导体有限公司整体业务架构
- 图表27：深圳市海思半导体有限公司销售网络布局
- 图表28：深圳市海思半导体有限公司芯片设计业务布局优劣势分析
- 图表29：紫光集团有限公司发展历程
- 图表30：紫光集团有限公司基本信息表
- 图表31：紫光集团有限公司股权穿透图
- 图表32：紫光集团有限公司经营状况
- 图表33：紫光集团有限公司整体业务架构
- 图表34：紫光集团有限公司销售网络布局
- 图表35：紫光集团有限公司芯片设计业务布局优劣势分析
- 图表36：北京豪威科技有限公司发展历程
- 图表37：北京豪威科技有限公司基本信息表

详细请访问：<http://www.cction.com/report/202406/462334.html>